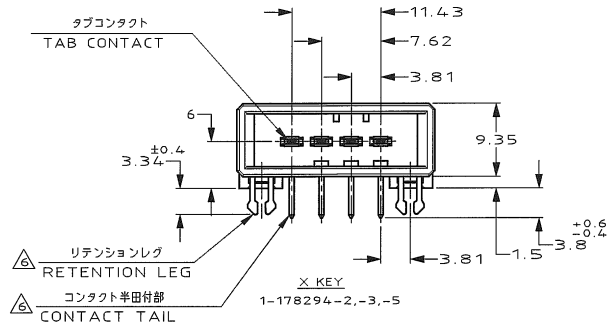
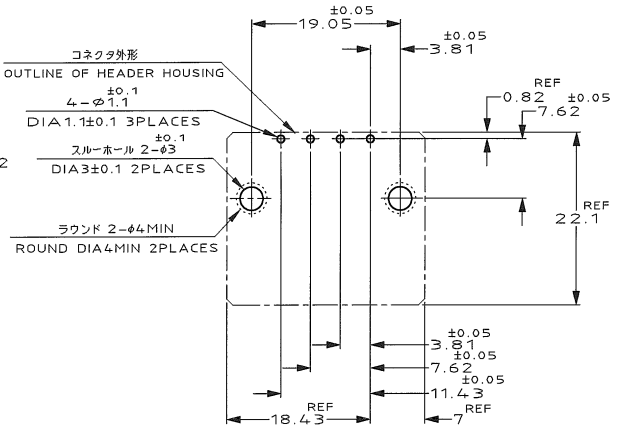
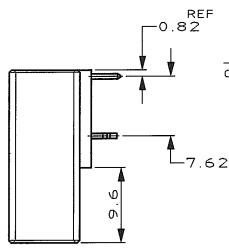
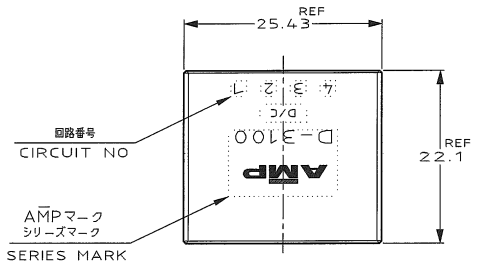


NUMBER 178294

3-2 ANGLE PROJECTION

METRIC

PRINT DIST DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

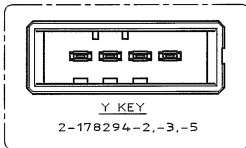
RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED
- FINISH (CONTACT TAIL): OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED
- FINISH (CONTACT TAIL): OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエスチル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき



△	△	1,2-178294-5
△	△	1,2-178294-3
△	△	1,2-178294-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

Copyright © 1994 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mmT(AWG)		mmφ		ダイナミック 3100 シリーズ 4極 ヘッダーアセンブリー (水平タイプ) 4 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
B	REVISED(FJD0-0039-03)	T	SM	25	APR
A	REVISED(FJD0-0114-03)	T	SM	10	03
0	RELEASED(FJ00-1468-94)	K	SM	10	95
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	
				22/DEC/94	
				DR. K.IKEDA	DE. K.IKEDA
				CHK. S.MANABE	APP. S.MANABE
				GENERAL TOLERANCES	
				100P ±0.3	
				100EL 30P ±0.4	
				300EL 100P ±0.5	
				★ ±0.3	
				SIZE LOC NUMBER	
				A3 J	
				SCALE 2-1	
				REV. B	
				SHEET 1 OF 1	
				C-178294	

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面